

Title (en)
Electromagnetic power relais.

Title (de)
Elektromagnetisches Leistungsrelais.

Title (fr)
Contacteur électromagnétique.

Publication
EP 0476183 A2 19920325 (DE)

Application
EP 90124828 A 19901219

Priority
DE 9013223 U 19900918

Abstract (en)

In the relay, a spring support (12) and a mating contact element (11) are inserted into slots in a base body (1) from two opposite sides and are guided by connecting rails (11a, 12a) parallel along the outer walls to an end side. At the end side, the connecting elements are bent away inside pockets (22) of the housing cap (18) and emerge in the form of end sections having solder and plug connections (20, 21) at a predetermined insulating separation out of the outer walls of the relay. Inside the pockets (22), the connecting elements are additionally anchored by means of integrally formed attachment tabs (11d, 12d), these attachment tabs also lying in the inwardly offset plane of the connecting elements. In consequence, the solder and plug connections are arranged at a sufficient insulating separation from the side contour of the relay, so that high-density packing of the relays on a printed-circuit board is possible. <IMAGE>

Abstract (de)

Bei dem Relais sind ein Federträger (12) und ein Gegenkontaktelement (11) von zwei entgegengesetzten Seiten in Schlitze eines Grundkörpers (1) eingesteckt und mit Anschlußschielen (11a, 12a) parallel entlang der Außenwände zu einer Stirnseite geführt. An der Stirnseite sind die Anschlußelemente innerhalb von Taschen (22) der Gehäusekappe (18) abgekröpft und treten in Form von Endabschnitten mit Löt- und Steckanschlüssen (20, 21) in einem vorgegebenen Isolierabstand von den Außenwänden des Relais aus. Innerhalb der Taschen (22) sind die Anschlußelemente mittels angeformter Befestigungsnasen (11d, 12d) zusätzlich verankert, wobei auch diese Befestigungsnasen in der nach innen versetzten Ebene der Anschlußelemente liegen. Damit sind die Löt- und Steckanschlüsse in einem genügenden Isolierabstand von der Seitenkontur des Relais angeordnet, so daß eine dichte Anordnung der Relais auf einer Leiterplatte möglich ist. <IMAGE>

IPC 1-7

H01H 1/58; H01H 50/14

IPC 8 full level

H01H 1/58 (2006.01); **H01H 50/14** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 50/14 (2013.01 - EP US)

Cited by

FR3082353A1

Designated contracting state (EPC)
AT CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)

EP 0476183 A2 19920325; EP 0476183 A3 19920902; EP 0476183 B1 19940928; AT E112413 T1 19941015; CA 2051467 A1 19920319;
DE 59007352 D1 19941103; DE 9013223 U1 19920206; JP H04245124 A 19920901; PT 98987 A 19931029; PT 98987 B 19990129;
US 5144271 A 19920901

DOCDB simple family (application)

EP 90124828 A 19901219; AT 90124828 T 19901219; CA 2051467 A 19910916; DE 59007352 T 19901219; DE 9013223 U 19900918;
JP 23276091 A 19910912; PT 9898791 A 19910917; US 72564391 A 19910703